

Nr. 22, 09. April 2014

NETZSCH-Webinar – Clever Kleben: Charakterisierung von Klebstoffen mit Hilfe von DEA, DSC und DMA

Mit thermischer Analyse Klebstoffe und die damit verbundenen Prozesse genau analysieren – genau das ist das Ziel unseres kostenfreien Webinars „Clever Kleben“.

NETZSCH Analysieren & Prüfen bietet Anwendern, die täglich mit Klebstoffen arbeiten oder in Zukunft arbeiten werden einen Einblick in die dafür wichtigsten Methoden: Die DSC (dynamische Differenzkalorimetrie), die DEA (Dielektrische Analyse) und die DMA (Dynamisch-Mechanische Analyse).

Erfahren Sie in dem Webinar mehr über die Charakterisierung von Klebstoffen, lassen Sie sich informieren, wie Sie die optimale Vernetzung der Klebstoffmischung ermitteln oder lernen Sie, wie Sie am besten die mechanischen Eigenschaften des vernetzten Klebstoffes untersuchen. Applikationsbeispiele erklären unterstützend die Methoden.

Das Webinar vermittelt den Teilnehmern nicht nur, welche Art von Informationen mit den unterschiedlichen Analysegeräten erhalten werden können, es gibt auch die Möglichkeit, selbst Fragen zu stellen.

Melden Sie sich gleich an: www.netzsch.com/n11355